

無電解Pdめっき液「S-KPD」

主にNi基材に対して薄く均一にパラジウム皮膜を形成することを目的に開発された無電解Pdめっき液です。

●主な特徴

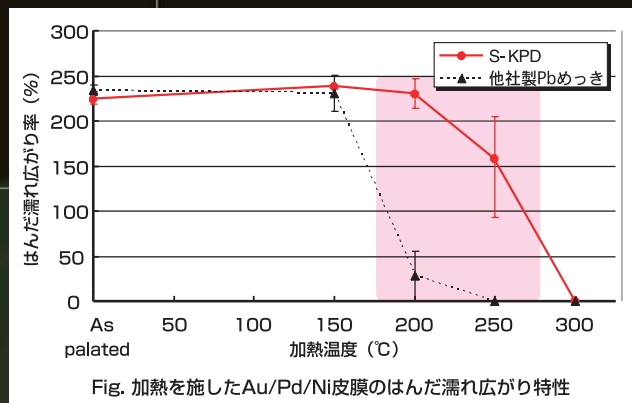
- ・薄い膜厚においても下地に対する被覆性に優れる
- ・ナノメートルオーダーでの膜厚制御が容易
- ・下地のNi層のダメージが少ない (Niの溶出量が少ない)

上記の特徴から、Niめっきの施されたリードフレームへのPd-PPF処理 (Au/Pd/Ni) やプリント配線板上への表面処理に好適です。

皮膜成分	純Pd
析出速度	35~40nm / 10min.
処理温度	60℃~70℃
処理時pH	弱酸性 (5.0~6.5)

(下地のNi-P皮膜として当社製「SFK-63」を対象とした場合)

●耐熱拡散特性 (はんだ濡れ広がり特性による評価)



大気雰囲気中で30分間加熱後に試験

基材 : 純銅

めっき処理 : Au 5nm / Pd 30nm / Ni-P 3 μ m

使用はんだ : 鉛フリーはんだ

ろう接条件 : 不活性雰囲気中において
300℃、1分間保持 (予備加熱無し)



日本カニゼン株式会社
JAPAN KANIGEN CO.,LTD